

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2011 年 8 月 4 日(04.08.2011)



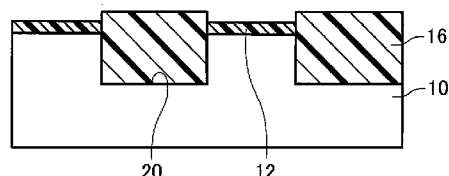
(10) 国際公開番号
WO 2011/093153 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) C09K 3/14 (2006.01)
B24B 37/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2011/050624
- (22) 国際出願日: 2011 年 1 月 17 日(17.01.2011)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2010-020109 2010 年 2 月 1 日(01.02.2010) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): J
S R 株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒
1058640 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号
Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 竹村 彰浩
(TAKEMURA, Akihiro) [JP/JP]; 〒 1058640 東京都
港区東新橋一丁目 9 番 2 号 J S R 株式会
社内 Tokyo (JP). 吉尾 浩平 (YOSHIO, Kouhei)
[JP/JP]; 〒 1058640 東京都港区東新橋一丁目 9 番
2 号 J S R 株式会社内 Tokyo (JP). 山中 達也
(YAMANAKA, Tatsuya) [JP/JP]; 〒 1058640 東京都
港区東新橋一丁目 9 番 2 号 J S R 株式会
社内 Tokyo (JP). 金野 智久 (KONNO, Tomohisa) [JP/
JP]; 〒 1058640 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2
号 J S R 株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 大淵 美千栄, 外 (OFUCHI, Michie et al.);
〒 1670051 東京都杉並区荻窪五丁目 2 6 番 1 3
号 荻窪 T M ビル 2 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS,
JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW,
MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH,
PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST,
SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア
(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR,
NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: AQUEOUS DISPERSION FOR CHEMICAL MECHANICAL POLISHING, AND CHEMICAL MECHANICAL
POLISHING METHOD USING SAME

(54) 発明の名称: 化学機械研磨用水系分散体およびそれを用いた化学機械研磨方法

[図3]



(57) Abstract: An aqueous dispersion for chemical mechanical polishing, characterized by comprising (A) silica particles each having at least one functional group selected from the group consisting of a sulfo group and salts thereof and (B) an acidic compound.

(57) 要約: 本発明に係る化学機械研磨用水系分散体は、(A) スルホ基およびその塩からなる群から選
択される少なくとも 1 種の官能基を有するシリカ粒子と、(B) 酸性化合物と、を含有することを特徴
とする。

WO 2011/093153 A1